

日月光一〇七年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 107 年 4 月 27 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇七年度第一季獲利報告，本公司一〇七年第一季之合併營業收入較一〇六年第四季下滑 23%，較一〇六年同期下滑 2%，為新台幣 64,966 百萬元。茲將日月光一〇七年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	107 年度 第一季	106 年度 第四季	106 年度 第一季
營業收入淨額	64,966	83,986	66,551
營業毛利	10,388	14,793	11,975
營業淨利（淨損）	4,316	7,706	5,225
稅前淨利（淨損）	3,776	7,879	3,845
所得稅利益（費用）	(1,420)	(1,085)	(886)
非控制權益	(260)	(548)	(400)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	2,096	6,246	2,559
基本每股盈餘(新台幣元)	0.25	0.74	0.33
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.24	0.71	0.29

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	107 年度 第一季	106 年度 第四季	106 年度 第一季
營業收入淨額	37,072	41,794	38,385
營業毛利	7,701	10,862	8,833
營業淨利（淨損）	3,418	6,001	3,983
稅前淨利（淨損）	3,401	7,099	3,207
所得稅利益（費用）	(1,250)	(776)	(570)
非控制權益	(55)	(77)	(78)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	2,096	6,246	2,559

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	46
電腦	13
汽車, 消費性電子及其它	41
前十大客戶佔營收比重	48

測試業務產品組合	%
後段測試	78
晶圓測試	19
前段測試	3
測試資本支出金額	54 百萬美元
測試機台數	3,801 台

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	32
IC Wirebonding	58
Discrete and Others	10
封裝資本支出金額	146 百萬美元
打線機台數	16,015 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	42
電腦	17
消費性電子	24
工業用	9
汽車電子	7
其它	1
前十大客戶佔營收比重	87
EMS 資本支出金額	7 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2018 年第二季的業績展望如下：

- 以美元計價之半導體封測事業第二季生意量將高於去年第二季，但低於去年第四季水準；
- 排除匯率影響，半導體封測事業第二季毛利率將約當於去年第二季水準；
- 電子代工服務第二季生意量將介於去年第二季與第三季之間；
- 電子代工服務第二季毛利率將略高於今年第一季毛利率。